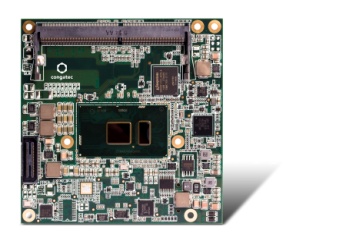
****

|  |  |
| --- | --- |
| **Leserkontakt:** | **Pressekontakt:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network** |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Telefon: +49-991-2700-0 | Telefon: +49-2405-4526720 |
| [info@congatec.com](mailto:info@congatec.com)  [www.congatec.com](http://www.congatec.com) | [info@sams-network.com](mailto:info@sams-network.com)  [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |

**

*congatec COM Express Compact Modul mit Gen 7 Intel® Core™ SoC Prozessor*

*Text und Foto verfügbar:* [*http://www.congatec.com/presse*](http://www.congatec.com/presse)

Produktvorstellung

congatec stellt neue COM Express Module mit   
Gen7 Intel® Core™ Prozessoren (Codename Kaby Lake) vor

**congatec’s neue Module sind einfach besser**

**Deggendorf, 3. Januar 2017 \* \* \*** congatec, ein führender Technologie-Anbieter für Embedded Computermodule, Single Board Computer und Embedded Design & Manufacturing Services, stellt parallel zum Lauch der 7ten Generation der Intel® Core™ SoC Prozessoren (Codename Kaby Lake) neue COM Express Compact Module vor. Die neuen conga-TC175 Computer-on-Module mit Intels Skylake Nachfolger – es ist die zweite Variante der aktuellen 14nm Mikroarchitektur – sind einfach besser als ihre Vorgänger. Sie bestechen unter anderem durch eine gesteigerte CPU Performance, eine durch 10 bit Video Codecs noch dynamischere HDR-Grafik sowie dem Support des optionalen, extrem schnellen 3D Xpoint basierten Intel® Optane™ Memory.

Dank der Kompatibilität zur Vorgängergeneration kann die rundum verbesserte Mikroarchitektur ohne zusätzlichen Designaufwand in bestehende Embedded Systeme integriert werden. Der standardisierte COM Express Formfaktor, congatec’s umfassende industrielle Treiberimplementierungen und der persönlicher Integrationssupport bis hin zu individuellen Embedded Design & Manufacturing Services tragen ihr übriges dazu bei, dass Entwicklern die Integration dieser neuen Generation besonders einfach gemacht wird. Zielapplikationen finden sich überall dort, wo bei 15 Watt TDP lüfterlose und komplett geschlossene Systeme höchste Leistung bieten müssen.

„Die aktuell vier 15 Watt Varianten der 7ten Generation der Intel® Core™ Prozessoren aus Intel‘s IOTG Embedded Roadmap werden echte Leistungsträger für die vielfältigen neuen Applikationsfelder des Embedded Computings. Sie werden quasi überall gebraucht: Von Industrie über Medical und Transportation bis hin zum Infotainment und Retail sowie in der Gebäude- und Homeautomation. Mit ihnen wird sich auch ein deutlicher Schritt hin zu neusten Betriebssystemen wie Windows 10 IoT vollziehen, das durch seine erweiterten Sicherheitsfunktionen und Sperrmöglichkeiten für IoT angebundene Geräte besticht“, erklärt Martin Danzer, Director Product Management bei congatec. Unterstützt werden darüber hinaus selbstverständlich auch alle weiteren aktuellen OS wie beispielsweise Linux 3.x/4.x, Yocto und Wind River VxWorks.

**Intel® Optane™ Memory**

Das von den neuen congatec COM Express Computermodulen unterstütze Intel® Optane™ Memory basiert auf der 3D Xpoint Technologie, die gegenüber NAND-SSDs eine deutlich geringere Latenz bietet aber genauso große Datenpakete verarbeiten kann. Mit einer Latenz von lediglich 10µs – gut tausendfach kleiner als die von Standard-HDDs – werden die Grenzen zwischen Arbeitsspeicher und Storage zudem fließend. Die Carrierboards von congatec unterstützen bereits die Evaluierung dieser schnellen Speichertechnologie, die sich speziell für die Big-Data-Verarbeitung, High-Performance-Computing, Virtualisierung, Datenspeicher, Cloud, Simulationen, Medical Imaging und viele weitere Anwendungen eignet.

**Das Featureset in Detail**

Die neuen COM Express Compact conga-TC175 Module sind mit den 15 Watt Dualcore-Varianten der Gen7 Intel® Core™ SoC Prozessoren bestückt. Konkret sind das die 2,8 GHz Intel® Core™ i7 7600U, 2,6 GHz Intel® Core™ i5 7300U und 2,4 GHz Intel® Core™ i3 7100U Prozessoren sowie auch der Intel® Celeron® 3695U Prozessor mit 2,2 GHz. Die TDP ist bei allen Varianten von 7,5 bis 15 Watt konfigurierbar, was die Anpassung der Applikation an das Energiekonzept des Systems erleichtert. Alle Module unterstützen bis zu 32 GB schnellen Dual Channel Speicher, der in DDR4 Auslegung deutlich bandbreitenstärker und energieeffizienter ist als bisher übliche DDR3L Implementierungen. Die Intel® Gen 9 HD Grafik 620 versorgt bis zu drei unabhängige Displays mit bis zu 4k @ 60 Hz via eDP 1.4, DisplayPort 1.2 und HDMI 2.0a. Für noch schnellere Windows 10 basierte 3D Grafik unterstützen sie zudem DirectX in der Version 12. Dank hardwarebeschleunigter 10 bit En- und Decodierung und High Dynamic Range von HEVC und VP9 werden HD-Streams in beide Richtungen noch plastischer und lebensechter. Die neuen congatec Computermodule unterstützen das COM Express Typ 6 Pinout mit PCI Express Gen 3.0, USB 3.0 und 2.0, SATA Gen 3, Gigabit Ethernet sowie low-speed Interfaces wie LPC, I²C und UART. Individueller Integrationssupport, umfassendes Zubehör sowie optionale Embedded Design & Manufacturing Services für individuelle Carrierboard- und Systemdesigns runden das Angebot ab.

Verfügbar sind die neuen congatec COM Express Compact Module in folgenden CPU Versionen:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prozessor** |  | **Cores / Threads** |  | **Intel® Smart Cache [MB]** |  | **Clock / Burst**  **[GHz]** |  | **TDP**  **[W]** |  | **Grafik** |
| **Intel® Core™  i7-7600U** |  | 2/4 |  | 4 |  | 2,8/3,9 |  | 15/7,5 |  | Intel® HD Graphics 620 |
| **Intel® Core™  i5-7300U** |  | 2/4 |  | 3 |  | 2,6/3,5 |  | 15/7,5 |  | Intel® HD Graphics 620 |
| **Intel® Core™  i5-7442EQ** |  | 2/4 |  | 3 |  | 2,4 |  | 15/7,5 |  | Intel® HD Graphics 620 |
| **Intel® Celeron®  3695U** |  | 2/2 |  | 2 |  | 2,2 |  | 15/10 |  | Intel® HD Graphics 610 |

Weitere Informationen zum neuen conga-TC175 Computer-on-Modul unter: [http://www.congatec.com/de/produkte/com-express-typ6/conga-TC175.html](http://www.congatec.com/de/produkte/com-express-typ6/conga-tc170.html)

**Über die congatec AG**

Mit Hauptsitz in Deggendorf, Deutschland ist die congatec AG ein führender Anbieter von industriellen Computermodulen auf den Standard-Formfaktoren COM Express, Qseven und SMARC sowie für Single Board Computer und EDM-Services. Die Produkte und Dienstleistungen des innovativen Unternehmens sind branchenunabhängig und werden z.B. in der Industrie-Automatisierung, der Medizintechnik, im Entertainment, im Transportwesen, bei Telekommunikation, Test & Measurement sowie Point-of-Sale Anwendungen eingesetzt. Wesentliche Kernkompetenz und technisches Know-How sind besondere, erweiterte BIOS Features sowie umfangreiche Treiberunterstützung und Board Support Packages. Die Kunden werden ab der Design-In Phase durch umfassendes Product Lifecycle Management betreut. Die Fertigung der Produkte erfolgt bei spezialisierten Dienstleistern nach modernsten Qualitätsstandards. congatec unterhält Niederlassungen in USA, Taiwan, China, Japan und Australien sowie in Großbritannien, Frankreich und Tschechien. Weitere Informationen finden Sie unter [www.congatec.de](http://www.congatec.de) oder bei [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) und [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel, Intel® Core, Celeron und Optane sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Intel® Corporation in den USA und anderen Ländern.*